FICHA TÉCNICA



SOLDADURA DE PLATA AL 5%- HARRIS

La soldadura de plata al 5% de Harris es un metal de aportación con fósforo-cobre pensado para unir cobre con cobre y cobre con latón de bajo contenido de zinc. Su buena fluidez y su mayor ductilidad permiten realizar uniones precisas y flexibles, incluso cuando el ajuste entre las piezas no es perfecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de producto: Soldadura de plata y Pasta fundente
- Composición: Plata al 5%
- Metal de aportación: fósforo-cobre
- Marca: Harris

BENEFICIOS

- Fluye rápidamente al calentarse, ideal para uniones con espacios reducidos
- Rango de fusión amplio que permite rellenar espacios más grandes
- Mayor ductilidad que la Stay-Silv 2 para uniones más flexibles
- Compatible con cobre a cobre y cobre a latón con bajo contenido de zinc
- Tolera uniones donde no es posible mantener un ajuste perfecto

RECOMENDACIONES

- Utiliza el fundente de soldadura blanco Stay-Silv al unir cobre con latón
- Calienta la unión de forma rápida para aprovechar la fluidez del metal
- Calienta con más lentitud cuando necesites rellenar espacios más amplios
- Limpia las superficies de cobre antes de aplicar la soldadura y el fundente

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación